证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-065

锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 20 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,337,697.02 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2051 号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 9 月 15 日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币 160,000,000.00 元增加至人民币 170,305,736.00 元，总股本由 160,000,000 股增加至 170,305,736 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定和要求。董事会同意公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-067

锦州神工半导体股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,337,697.02 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，公司保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见 2023 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

本公司《锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	210,000,000.00	备案项目代码：2302-210711-04-02-343592
2	补充流动资金	90,000,000.00	/
合 计		300,000,000.00	/

上述项目的投资总额为 39,879.19 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司此次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准、并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,818,829.10 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	210,000,000.00	2,818,829.10
合 计		210,000,000.00	2,818,829.10

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,943,396.22 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 518,867.92 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计及验资费用	377,358.49
2	律师费用	141,509.43
合 计		518,867.92

五、本次募集资金置换履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

综上，公司独立董事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（三）保荐人意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（四）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了神工股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

七、上网公告附件

（一）锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告；

（三）国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-068

锦州神工半导体股份有限公司关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见 2023 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目实施进度，由项目部或者采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式为使用银行承兑汇票，按公司相关规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

3、公司财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，抄送保荐代表人进行备案。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募投项目所使用的款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐人。

4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔交易资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

5、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、相关审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

综上，公司独立董事一致同意《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，公司监事会同意《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。

（三）保荐人意见

保荐人认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的核查意见。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-070

锦州神工半导体股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见 2023 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

本公司《锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	210,000,000.00	备案项目代码：2302-210711-04-02-343592
2	补充流动资金	90,000,000.00	/
合 计		300,000,000.00	/

上述项目的投资总额为 39,879.19 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司此次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准、并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,818,829.10 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	210,000,000.00	2,818,829.10
合 计		210,000,000.00	2,818,829.10

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,943,396.22 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 518,867.92 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计及验资费用	377,358.49
2	律师费用	141,509.43
合 计		518,867.92

五、本次募集资金置换履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

七、上网公告附件

（一）锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-069

锦州神工半导体股份有限公司关于 增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2051 号），同意公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 9 月 15 日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币 160,000,000.00 元增加至人民币 170,305,736.00 元，总股本由 160,000,000 股增加至 170,305,736 股。本次公司 2023 年度向特定对象发行股票新增股份 10,305,736 股已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将对《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 170,305,736.00 元。
第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 170,305,736 股，均为普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。根据公司 2022 年年度股东大会审议结果，本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-066

锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场的方式召开。会议已于 2023 年 10 月 20 日通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常实施。

综上，监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，公司监事会同意《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

综上，公司监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-061

东芯半导体股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，将本次激励计划授予价格由 22.00 元/股调整为 21.874 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）。

3、2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）。

4、2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对外披露了《东芯半导体股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

5、2023 年 5 月 9 日，公司召开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会将本次激励计划授予价格（含预留部分）调整为 21.874 元/股，认为预留授予条件已经成就。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会将本次激励计划授予价格（含预留部分）调整为 21.874 元/股，认为预留授予条件已经成就。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次激励计划调整情况

（一）调整事由

2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，2023 年 5 月 25 日公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），确定以 2023 年 5 月 30 日为股权登记日，向截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利 0.1260 元（含税），共计派发现金红利 55,723,469.51 元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

（二）调整结果

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派息事项，限制性股票授予价格的调整方法如下：

$P=P0-V$

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

因此，本次激励计划调整后的授予价格（含预留部分）$P=22.00-0.1260=21.874$ 元/股。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容